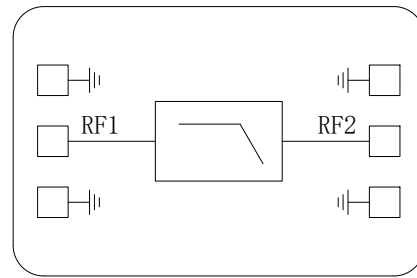


### 特点:

- 通带频率: DC~1.5GHz
- 通带损耗:  $\leq 1.7\text{dB}$
- 阻带衰减:  $22\text{dB}@2\text{GHz}$   
 $40\text{dB}@2.6\text{GHz}$
- 回波损耗:  $18\text{dB}$
- 芯片尺寸:  $1.3\text{mm}\times 0.6\text{mm}\times 0.1\text{mm}$

### 功能框图:



### 产品简介:

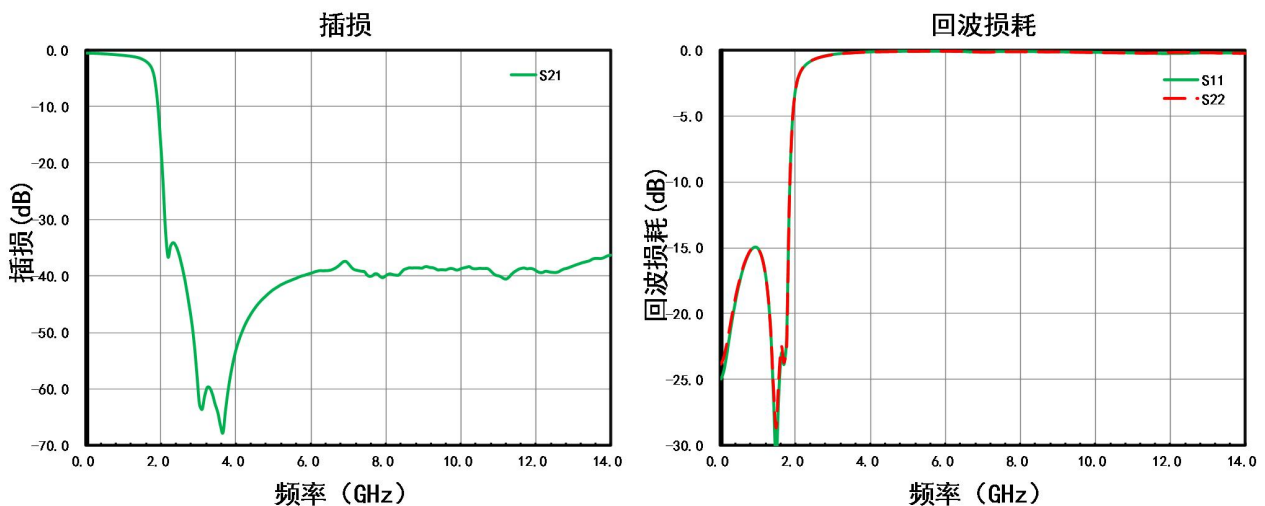
YDC8604 是一款采用 GaAs pHEMT 工艺设计制造的低通滤波器芯片。该芯片采用了片上金属化通孔工艺保证良好接地。芯片背面进行了金属化处理，适用于导电胶粘接或共晶烧结工艺。

### 性能参数: (50Ω系统, $T_A=+25^\circ\text{C}$ )

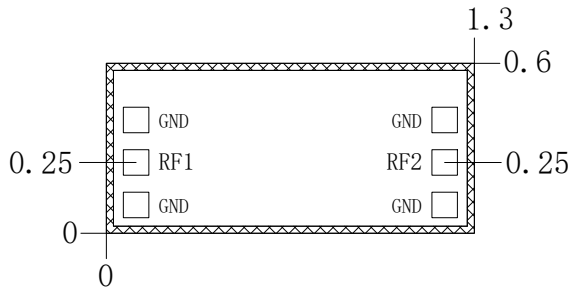
参数名称	符号	参数值			单位
		MIN	TYP	MAX	
频率范围	f	DC		1.5	GHz
插入损耗	IL			1.7	dB
阻带衰减@2GHz			22		dB
阻带衰减@2.6GHz			40		dB
端口回波损耗	RL		18		dB

\*: 芯片均经过在片 100% 直流与 RF 测试。

### 典型测试曲线: (50Ω系统, $T_A=+25^\circ\text{C}$ )



### 外形尺寸图:



注: 1.单位: mm;

- 2.芯片背面镀金, 背面接地;
- 3.外形尺寸公差:  $\pm 0.05\text{mm}$ 。
- 4.键合压点镀金, 压点尺寸:  $0.1 \times 0.1\text{mm}$ ;

### 引脚定义:

符号	描述
RF1	射频端口, 芯片内部无隔直
RF2	射频端口, 芯片内部无隔直
GND/芯片背面	接地, 芯片底部需接地良好

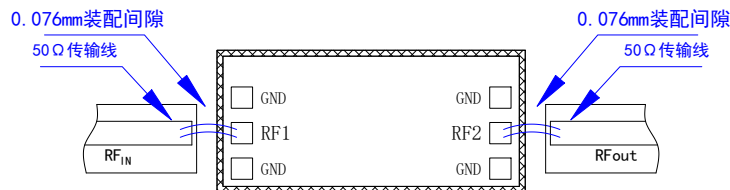
### 极限参数表:

参数名称	极限值
最大输入	+25dBm
装配温度	+295°C, 30s
工作温度	-55°C~+125°C
贮存温度	-65°C~+150°C

超过以上任何一项极限参数, 可能造成器件永久损坏。



### 推荐装配图:



注: 射频端口应尽量靠近微带线以缩短键合金丝尺寸, 典型的装配间隙是  $0.076\sim 0.152\text{mm}$ , 使用  $\Phi 25\mu\text{m}$  双金丝键合, 建议金丝长度  $250\sim 400\mu\text{m}$ 。

### 产品使用注意事项:

1. 本芯片产品需要在干燥、氮气环境中存储, 在超净环境装配使用。
2. 裸芯片使用的砷化镓材料较脆, 芯片表面容易受损, 不能用干或湿化学方法清洁芯片表面, 使用时须小心。
3. 芯片粘结装配时, 需考虑热膨胀应力对芯片的影响, 芯片建议烧结或粘结在热膨胀系数相近的载体上, 如可伐、钨铜或钼铜垫片上, 避免热膨胀应力匹配不当导致芯片开裂。
4. 芯片使用导电胶或合金烧结 (合金温度不能超过  $300^\circ\text{C}$ , 时间不能超过 30 秒), 使之充分接地。
5. 芯片射频端口使用  $25\mu\text{m}$  双金丝键合, 建议金丝长度  $0.25\sim 0.40\text{mm}$  ( $10\sim 16\text{mils}$ )。
6. 在存储和使用过程中注意防静电, 烧结、键合台接地良好。